



H6360SP 导热凝胶(可塑性导热填充)

产品描述

H6360SP 导热凝胶是一种有机硅材料，具备优越的耐高低温性，极好的耐气候、耐辐射及优越的介电性能。可按需求捏成某种形状，填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间，使其紧密接触、减小热阻，快速有效地降低电子原件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。

产品优点：

- 可塑性导热填充
- 高功率 6.0w/m.k，具有优秀的导热性能
- 具备优异的长期热稳定性、高可靠性，能承受苛刻的热冲击、冷热循环测试
- 良好的电气绝缘性

技术参数

在推荐的条件下固化：

性能	YTG600SP	测试方法
导热系数	6.0 W/m·K	ASTM D5470
颜色	灰色	目视
流速	40 g/min	30cc 针管，90psi
密度	3.4 g/cm ³	ASTM D792
击穿电压	≥5 KV	ASTM D149
体积电阻	≥1×10 ¹² ohm·cm	ASTM D257
其它性能		



固化时间 (25°C)	> 20 天	--
固化时间 (100°C)	60 min	--
长期使用温度	-40-150°C	--
挥发物质量损失率	≤0.1%	ASTM E595

使用指南

存储：建议将导热凝胶存储在 (<10 °C)的环境中。

使用环境：导热凝胶在高低温的环境中应用性能表现优异，可以保证在-40-150°C的温度区间内长期使用。

点胶：配合混合针管，使用点胶机或胶枪即可点胶在需使用位置；桶装组合按照 1:1 比例，将 B 组份加入到 A 组份中混合均匀，然后再通过点胶 / 涂抹 / 印刷等装配方式使用在设计位置；

固化：将组件装备好后室温或加热固化。冬季若固化时间太长时，建议采用加热固化方式。

注意事项

- 仅限于工业用途
- 使用前须佩戴好护目镜及操作手套
- 操作空间须具有良好的通风换气条件

标准包装

- 30 ml, 300ml, 600ml / 支
- 根据客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性。有关本产品的安全注意事项，请查阅安全数据资料(MSDS)。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。



避免阳光直晒并储存于阴凉处，置于儿童不可接触到的范围。在低于 10°C 保存在原装密闭容器中，H6360SP 的标准有效期是从生产日期起 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.cn